# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-236459

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	ΓI			技術表示箇所
H01L	21/205			H 0 1 L	21/205		
C 2 3 C	16/44			C 2 3 C	16/44	D	
H01L	21/31			H 0 1 L	21/31	В	

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 3 頁)

特願平7-63324 (21)出願番号

(22)出願日 平成7年(1995)2月27日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 執行 正一

長崎県諫早市津久葉町1883番43 ソニー長

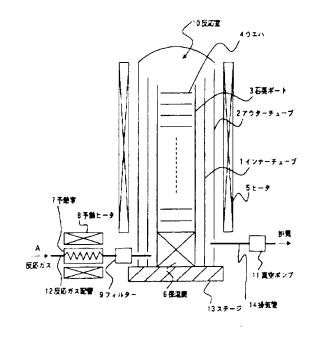
崎株式会社内

## (54) 【発明の名称】 CVD装置

## (57)【要約】

【目的】 反応ガスの予熱手段を備えたCVD装置にお いて、反応ガスの中間生成体からなる不純物を除去し膜 質の向上を図ったCVD装置を提供する。

【構成】 反応室10内に複数枚のウェハ4を収容し、 この反応室に連結された反応ガス配管12上に反応ガス を予熱するための予熱手段7、8を設けたCVD装置に おいて、上記予熱手段7、8と反応室10の間の反応ガ ス配管12上にフィルター9を設けた。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 反応室内に複数枚のウェハを収容し、 この反応室に連結された反応ガス配管上に反応ガスを予 熱するための予熱手段を設けたCVD装置において、 上記予熱手段と反応室の間の反応ガス配管上にフィルタ ーを設けたことを特徴とするCVD装置。

【請求項2】 前記フィルターは、予熱による反応ガス の中間生成物を除去するためのセラミックス系フィルタ 一またはメタルフィルターからなることを特徴とする請 求項1に記載のCVD装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体基板上に薄膜を 形成するためのCVD装置に関する。詳しては、反応ガ ス配管上にフィルターを設けることによって、不純物を 除去しようとしたCVD装置に係るものである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体装置の製造工程における薄膜形成 のために、減圧CVD装置が用いられている。この減圧 ェハをセットし、反応室を加熱した状態で反応ガスを導 入してウェハ上に薄膜を化学的に気相成長させるもので ある。従来の減圧CVD装置においては、反応ガスを常 温のまま反応室内に導入していたため、特に反応ガスの 上流域において反応ガスの昇温および活性化が充分でな く、反応室内での分解、成膜プロセスにおける活性化工 ネルギーの不足による膜質の劣化等の問題を生じてい た。

【0003】このような問題に対処するため、反応室内 に反応ガスを導入する前にこの反応ガスを予め加熱し、 加熱された反応ガスを反応室内に導入することによって 膜質の均一化を図ったCVD装置が提案されている(特 開平5-335250号公報、特開平5-234903 号公報)。

## [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記公 報記載のCVD装置においては、反応ガスを反応室内に 導入する前の予熱工程において、反応ガスの重合生成物 等の中間体が生成され、これが反応室内に流入して不純 物となってウェハ上に付着したり、あるいはウェハ上で 40 の気相成長の化学反応に影響して半導体特性や膜質を不 安定にし品質の低下を来すおそれがあった。

【0005】本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みな されたものであって、反応ガスの予熱手段を備えたCV D装置において、反応ガスの中間生成体からなる不純物 を除去し膜質の向上を図ったCVD装置の提供を目的と する。

## [0006]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明では、反応室内に複数枚のウェハを収容し、

この反応室に連結された反応ガス配管上に反応ガスを予 熱するための予熱ヒータ等の予熱手段を設けたCVD装 置において、上記予熱手段と反応室の間の反応ガス配管 上にフィルターを設けたことを特徴とするCVD装置を 提供する。

【0007】好ましい実施例においては、前記フィルタ 一は、予熱による反応ガスの中間生成物を除去するため のセラミックス系フィルターまたはメタルフィルターか らなることを特徴としている。

#### 10 [0008]

【作用】反応ガスが予熱手段を通過する間に生成された 反応ガスの中間体は、反応室の前に設けられたフィルタ ーにより除去される。

## [0009]

【実施例】図1は、本発明の実施例に係る減圧CVD装 置の要部構成図である。石英管からなるインナーチュー プーの外周を覆って同じく石英からなるアウターチュー プ2が設けられる。インナーチュープ1内に、例えば4 本の支柱形状の石英ポートが設けられ、各支柱に形成さ CVD装置は、減圧した反応室内に成膜すべき半導体ウ 20 れた溝にウェハ4を装着して複数枚の水平なウェハ4を 縦方向に所定間隔で重ねて支持する。このように内部に ウェハ搭載用石英ポート3を備えたアウターチューブ2 の内部が反応室10を構成する。アウターチューブ2の 下部には真空ポンプ11が排気管14を介して接続され る。アウターチューブ2の外周には電気抵抗体からなる ヒータ5が設けられ成膜プロセス時にウェハ4を加熱す る。

> 【0010】石英ポート3の下側には石英からなる保温 筒6が設けられる。この保温筒6は、成膜プロセス時に 30 反応室下部からウェハが冷却されないように保温するた めのものである。石英ポート3および保温筒6は昇降動 作可能なステージ13上に支持され、ウェハの出し入れ 時に石英ポート3にセットしたウェハ4とともにインナ ーチューブ1内を上下動作する。

【0011】インナーチュープ1の下部に反応ガス配管 12が接続される。この反応ガス配管12上に予熱ヒー タ8を周囲に有する予熱室7が設けられる。この予熱室 7とインナーチューブ1との間の反応ガス配管12上に フィルター9が設けられる。このフィルター9として は、ポーラス状のセラミックス系フィルターやメタルフ ィルターあるいはガラスフィルターを用いることができ るが、高温に対処するためにセラミックス系フィルター あるいはメタルフィルターが望ましい。なお、予熱室7 は熱交換器形状やコイル形状等であってもよいが、単に 反応ガス配管12上に予熱ヒータ8を装着した構成であ ってもよい。

【0012】上記構成の減圧CVD装置において、成膜 時にウェハ上に例えばポリシリコンやアモルファスシリ コンあるいはナイトライド等を減圧CVDプロセスによ り形成する場合、反応ガスとしてシランガスが、矢印A

50

のように反応ガス配管12を通してインナーチュープ1 の内側下部より反応室10内に供給される。反応条件 は、例えば温度610℃、圧力25Pa、シランガス流 量140gccmである。このシランガスは反応室に導 入される前に予熱室7で約300℃程度まで加熱され る。なお、この予熱温度は成膜の種類や成膜条件お上び ガスの種類等に応じて適当な任意の温度に設定すること ができる。このようにシランガスを予熱することによ り、シランの重合生成物等の中間体が形成される。この 物とともに反応室直前に設けたフィルター9により除去 される。このようにして不純成分が除去された反応ガス は、インナーチューブ1の下部より反応室10内に流入 し、石英ポートにセットされたウェハに接しながら上昇 し各ウェハ4上に所定の成膜条件の薄膜を形成する。こ のとき、ヒータ5により、石英ポート3上のウェハ4 は、反応室10の中央部で約610℃、上部で約615 ℃、下部で約605℃程度に加熱される。

【0013】反応ガスは、インナーチューブ1内を上昇 してその上部からアウターチューブ2とインナーチュー 20 プ1との間の隙間を通して下方に流れ、アウターチュー プ2に接続された排気管14を通して反応室の外部に排 出される。

【0014】なお、上記実施例はホットウォール型減圧 CVD装置について説明したが、本発明はコールドウォ ール型減圧CVD装置やプラズマCVD装置および常圧 CVD装置に対しても適用可能である。

【0015】また、反応ガス系統が複数ある場合、ある いは複数種類のガスを別々に反応室内に導入する場合に は、反応室に接続される各々のガス配管上にフィルター

【0016】また、ガス配管上のフィルターの位置は、 上記実施例の図では反応室の外側に設けているが反応室 (インナーチューブ) の内側であってもよい。

## [0017]

を設けることが望ましい。

【発明の効果】以上説明したように、本発明において ような反応ガスの予熱により生じた中間体は、他の不純 10 は、反応ガスを予熱した後、フィルターを通して反応室 内に導入しているため、予熱により生じた反応ガスの中 間体が、反応ガス中に混入している他の不純物とともに 反応室の直前で除去される。これにより、予備加熱によ り反応ガスを充分活性化して反応時の分解から成膜に至 るプロセスを良好な状態で行うことができるとともに、 予備加熱により生じた中間体等の不純物成分を除去して 品質の高い薄膜形成が可能になり、半導体装置の特性の 向上や安定化に寄与しまた歩留りの向上が図られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施例に係る減圧CVD装置の構成 図である。

## 【符号の説明】

1:インナーチューブ、2:アウターチューブ、3:石 英ポート、4:ウェハ、5:ヒータ、6:保温筒、7: 予熱室、8:予熱ヒータ、9:フィルター、10:反応 室、11:真空ポンプ、12:反応ガス配管、13:ス テージ、14:排気管。

[図1]

